



2024年12月02日

「ネプコン ジャパン展」に出展

ハリマ化成グループ株式会社

ハリマ化成グループは、2025年1月22日（水）～24日（金）に東京ビッグサイトで開催されるアジア最大級 エレクトロニクス総合展「ネプコン ジャパン」に出展します。ネプコンは7展で構成されており、当社は「電子部品・材料 EXPO」に展示します。



<https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp/about/ele.html>

【展示会情報】

・日時

2025年1月22日（水）～24日（金）10:00～17:00

・会場

東京ビッグサイト

〒135-0063 東京都江東区有明 3-11-1

アクセス：<https://www.bigsight.jp/visitor/access/>

・入場料

無料（事前登録制）

* 下記より事前登録できます

<https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1226047178782024-H2K>

【当社情報】

・ブース番号

E21-39

・出展情報

「半導体モールド用離形フィルム」、「フィルム用離型剤」、「ナノ粒子分散技術」を展示するとともに、展示品の説明会を予定しています。詳しくは、こちらをご覧ください：[ハリマ特設サイト](#)

以上

本件に関するお問い合わせ先
ハリマ化成グループ株式会社
広報グループ
TEL : 06-6201-2477
URL : <https://www.harima.co.jp/inquiry.php>